

ごあいさつ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、日揮グループは、12月11日(水)から12月13日(金)にかけて東京ビッグサイトにおいて開催されます「SEMICON Japan 2024」に出展します。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひご来場くださいますようお願い申し上げます。

敬具

JGC 日揮グループ

JGC 日揮ホールディングス株式会社

JGC 日揮グローバル株式会社

JGC C&C 日揮触媒化成株式会社

JFC 日本ファインセラミックス株式会社

出展のお知らせ
SEMICON Japan 2024

我々の本気、お見せします!

日揮グループは創業以来、石油精製・天然ガスを代表とする様々な分野のプラント・工場のEPC(設計・調達・建設)だけではなく、触媒やファインセラミックスの製造といった、多様な事業に携わり貢献してきました。半導体分野においては、“半導体関連工場の設計・施工”、“半導体製造装置向け部品”、“半導体材料向け素材”を軸に多角的に半導体産業を支えています。以下の日程で開催する「Exhibitor's TechSPOT Hall5」では、日揮グループの半導体分野での取り組み実績や今後目指す半導体ビジネスの展望について、具体例を交えてご紹介します。

東展示棟



SEMICON® JAPAN

半導体の未来がここにある。

会期 | 12月11日(水)~12月13日(金)
10:00~17:00

会場 | 東京ビッグサイト(東5ホール)
弊社出展小間: No.6032

「日揮グループが追求する半導体分野でのビジョン」

■ 日時: ①12月11日(水) 12:30~12:50
②12月13日(金) 13:30~13:50

■ 場所: 東5ホール
Exhibitor's TechSPOT Hall5

■ 登壇者: 日揮ホールディングス株式会社
執行役員
Chief Manufacturing Officer (CMO)
森嶋 浩之



半導体産業を支える 日揮グループ

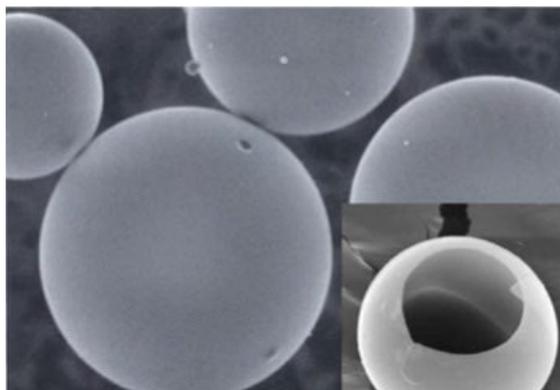


JGC 日揮グローバル株式会社

半導体デバイス、および半導体デバイスの製造工程に欠かせない化学材料の生産設備に係る企画・設計・建設をサポートします。世界87か国2万件以上の多種多様な設備建設案件で培った経験を活かし、お客様にとって最適な工法・設計をご提案、そして確実なプロジェクト遂行により、海外での設備投資計画を実現します。



JGC C&C 日揮触媒化成株式会社



バルーンシリカ

半導体向けを始め、様々なナノ技術を駆使した素材を製造・販売しており、触媒開発で培った要素技術を追求・応用しています。半導体分野では、シリカを用いたシリコンウエハー研磨用やCMP用、低誘電率を有するバルーンシリカといった素材を研究・開発しています。素材の力で半導体業界に貢献します。

JFC 日本ファインセラミックス株式会社

半導体製造装置向けの部品を製造・販売しています。耐熱、耐食、耐摩耗のエンジニアリングセラミックス、当社独自の金属セラミックス複合材料MMC、基板製造から薄膜回路形成まで社内一貫生産のエレクトロニクスセラミックス、次世代パワー半導体に不可欠な高熱伝導窒化ケイ素基板が半導体業界に貢献します。環境・エネルギー領域に向けた技術開発も展示します。



エンジニアリングセラミックス

お問い合わせ

日揮ホールディングス株式会社 戦略企画オフィス 経営企画ユニット Email : jgc_semiconductor@jgc.com